

证券代码：688099

证券简称：晶晨股份

公告编号：2025-019

晶晨半导体（上海）股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 晶晨半导体（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度利润分配方案为：本次不分配利润，资本公积不转增。
- 本年度现金分红比例低于 30%，是基于行业发展情况、公司发展阶段、研发投入需要、自身经营模式及资金需求的综合考虑。未来公司将继续努力做好业务经营，进一步推动盈利水平的提升。2025 年，公司将积极推进股份回购的相关事宜。
- 本次利润分配方案已经公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
- 未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于公司股东的净利润为人民币 821,921,406.70 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 2,348,745,151.74 元。充分考虑到公司目前处于快速

成长期，研发投入大，经营规模不断扩大，资金需求较大，为更好地维护全体股东的长远利益，公司2024年度不分配利润，资本公积不转增。

本次利润分配方案已经公司第三届董事会第十五次会议及第三届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

(二) 是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分配符合相关法律法规及公司章程的规定，公司不存在可能触及其他风险警示情形的情形，相关数据及指标如下表：

| 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 |
|----------------------------|------------------|----------------|----------------|
| 现金分红总额 (元) | - | 208,159,508.54 | - |
| 回购注销总额 (元) | - | - | - |
| 归属于上市公司股东的净利润 (元) | 821,921,406.70 | 498,036,099.27 | 726,660,355.61 |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润 (元) | 2,348,745,151.74 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额 (元) | 208,159,508.54 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于3000万元 | 否 | | |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额 (元) | - | | |
| 最近三个会计年度平均净利润 (元) | 682,205,953.86 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 (元) | 208,159,508.54 | | |
| 现金分红比例 (%) | 30.51 | | |
| 现金分红比例 (E) 是否低于30% | 否 | | |
| 最近三个会计年度累计研发投入金额 (元) | 3,820,838,891.93 | | |
| 最近三个会计年度累计研发投入金额是否 | 是 | | |

| | |
|--|-------------------|
| 在3亿元以上 | |
| 最近三个会计年度累计营业收入 (元) | 16,842,173,017.90 |
| 最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例 (%) | 22.69 |
| 最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例 (H) 是否在15%以上 | 是 |
| 是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否 |

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

公司 2024 年度拟分配的现金红利金额与当年归属于上市公司股东的净利润之比低于 30%，是基于行业发展情况、公司发展阶段、研发投入需要、自身经营模式及资金需求的综合考虑，具体原因分项说明如下。

(一) 公司所处行业情况及特点

公司处于集成电路设计行业，主要根据终端市场的需求设计开发各类芯片产品。集成电路具有产品换代节奏快、技术含量高的特点。集成电路设计行业是应用与产品导向、人才密集、创新密集、技术密集、知识产权密集型的行业，产品研究开发是该行业的核心驱动。芯片设计企业需要持续投入大量资金不断开发新技术，将技术标准更新换代，以实现产品性能、性价比不断优化。集成电路设计企业通过高额的研发投入开发出先进的技术和产品，通过产品的竞争力获得更大的市场份额和更高的利润率，从而更多地投入研发，依此形成良性循环，推动企业不断发展。

(二) 公司发展阶段和自身经营模式

公司为典型的 Fabless 模式，即无晶圆厂生产制造，仅从事集成电路的设计研发和销售。公司主营业务为系统级 SoC 芯片及周边芯片的研发、设计与销售，目前主要产品有多媒体智能终端 SoC 芯片、无线连接芯片、汽车电子芯片等，为众多消费类电子领域提供 SoC 主控芯片和系统级解决方案。公司产品已广泛应用于家庭、汽车、办公、教育、体育健身、工业、商业、农业、娱乐、仓储等领域，应用场景不断增加。

目前，公司已在现有主营业务领域取得了一定的积极成果，自主研发出了多项关键核心技术和具有全球竞争力的产品，但为了进一步巩固并提升公司在全球市场中的竞争力与竞争优势，公司仍存在持续加大对新技术、新应用领域的研究开发的内在需求。因此，在现阶段，公司需要进一步投入大量资金用于投入研发和开拓市场等，有力保障公司内生式发展、外延式投资等资金需求。

（三）公司盈利水平及资金需求

公司 2024 年度实现归属于公司股东的净利润为人民币 821,921,406.70 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 2,348,745,151.74 元。

2025 年公司将持续加大对现有产品的升级换代和新产品的研发投入，进一步增强研发实力。在巩固国内市场的同时，进一步拓展海外市场，开拓新客户、新区域，拓展新的应用场景，进一步做大增量，成就公司新增长，为股东赢得良好回报。与此同时，在内生式发展的基础上，公司会结合所处行业发展趋势、自身的战略规划及自身的经营需求适时考虑通过投资入股、并购等方式推动公司持续健康快速发展。在此过程中，公司需要更多资金以保障前述目标的实现，为公司未来的持续快速发展及外延式投资提供积极支撑。

（四）公司现金分红水平较低的原因

目前，公司处于快速成长期。为了持续提升公司竞争力，确保长期竞争优势，提升公司及股东的长期价值，公司需要持续保持高强度的研发投入。同时，为了巩固并进一步提升公司国内国际的市场占有率，公司需要进一步开拓新客户、新区域，拓展新的应用场景。为此，公司需要大额的投入以开发先进技术和产品以及开拓市场等，在此过程中需要大量资金支持。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

2024 年末公司留存未分配利润将累积滚存至下一年度，用于研发投入、日常经营。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等相关规定的要求，并结合公司所处发展阶段、经营情况、现金流等各种因素，积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展的成果，更好地维护全体股东的长远利益。

(六) 公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利措施

公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公司股东大会以现场会议形式召开，并提供网络投票的方式为股东参与股东大会决策提供便利。

(七) 公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

2025 年，公司将积极推进股份回购的相关事宜。未来公司将继续努力做好业务经营，进一步推动盈利水平的提升，并严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策。

三、公司履行的决策程序

(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 10 日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》，同意本次利润方案，同意将该方案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(二) 监事会意见

公司于 2025 年 4 月 10 日召开的第三届监事会第十四次会议审议通过了《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》，监事会认为公司 2024 年度利润分配预案是公司基于行业发展情况、公司发展阶段、研发投入需要、自身经营模式及资金需求的综合考虑，符合法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司经营现状，有利于公司长期发展规划，不存在损害公司及公司股东，特别是中小股东利益的情形。因此监事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

四、相关风险提示

(一) 现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

公司 2024 年度利润分配方案综合考量了公司目前经营状况、发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

(二) 其他风险说明

公司 2024 年度利润分配方案需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

晶晨半导体（上海）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 11 日